

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度 评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“普冉股份”）于 2026 年 3 月 21 日发布了《“提质增效重回报”2025 年度方案执行情况及 2026 年度行动方案的报告》。自行动方案发布以来，公司紧密围绕聚焦经营主业、强化技术创新、优化财务管理、完善公司治理、重视投资者回报等核心方向，系统推进各项工作。现将 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估情况公告如下：

一、经营发展

1、公司经营情况概述

公司自 2016 年成立以来，始终以“普冉之芯，造福世界”为愿景，专注于非易失性存储器芯片的研发创新，致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的芯片产品及解决方案。经过多年深耕，公司已形成存储、“存储 X”、“存储+”三大战略条线协同发展的业务格局，产品分别涵盖 NOR Flash、EEPROM；高性能 2D NAND 及衍生存储器产品；MCU、模拟芯片等，广泛应用于手机、PC、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

（1）存储战略

在存储战略条线方面，公司充分发挥自身在特色工艺设计和市场拓展方面的优势，巩固了在非易失性存储器领域的领先地位。公司已实现 SONOS 和 ETOX 双工艺平台全容量系列的产品覆盖，NOR Flash 产品覆盖 512Kbit 至 1Gbit 容量系列，支持 1.1V 至 3.6V 宽电压操作。其中，在工艺节点上，SONOS 特色工艺第二代 40nm 制程产品已经成为量产交付主力，第三代工艺平台 40E 系列产品也已经成功推出。ETOX 传统工艺 4Mbit~1Gbit 已实现大批量出货，公司 256Mbit~1Gbit 产品

应用于 PC、通讯、服务器等领域，并持续推进客户拓展。此外，公司 ETOX 平台最新一代制程已达 4Xnm，实现了 4Mbit~256Mbit 的批量出货，应用于 IPC、CAT1（LTE UE-Category 1，智能网联终端）等领域，为行业领先水平。

EEPROM 产品覆盖 2Kbit 至 2Mbit 容量，操作电压覆盖 1.2V 至 5.5V，部分中大容量产品采用 55nm 工艺制程并已实现量产。公司持续推进 EEPROM 产品在工业控制和车载领域的应用，车载产品完成 AEC-Q100 Grade1 标准的全面考核，在车身摄像头、车载中控、娱乐系统等应用上实现了海内外客户的批量交付，同时完成了多家国内 Tier1 厂商的认证，汽车电子产品营收占比有所提升。

公司超大容量 EEPROM 系列产品，支持 SPI/I2C 接口和最大 2Mbit 容量，其中 2Mbit 产品批量用于高速宽带通信和数据中心。

与此同时，公司推出的超低电压 1.2V 系列 EEPROM 已实现量产出货，涵盖 32Kbit 至 512Kbit，是目前行业内工艺节点领先和容量覆盖面较为完备的超低电压产品线。

报告期内，公司 EEPROM 产品线重要组成部分 SPD（Serial Presence Detect，串行存在检测，一种访问内存模块有关信息的标准化方式）产品线批量出货，已成功导入重点大客户。该系列主要产品为 SPD 及 TS（Temperature Sensor，温度传感器），具有高可靠性特点，能够满足相关应用场景对数据保存的较高要求，主要配套新一代 DDR5 内存条，应用于计算机和服务器内存条，可存储内存条相关信息，如内存的容量、速度、电压等，帮助计算机系统正确识别和配置内存，确保内存正常工作。

（2）“存储 X”战略

2025 年 11 月，公司通过现金收购方式控股珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称“诺亚长天”），将其全资子公司 SkyHigh Memory Limited（以下简称“SHM”）纳入合并报表范围，正式切入 2D NAND 和 MCP 赛道，实现了从芯片设计到固件算法、封装模组的全产业链覆盖，帮助公司完成了“存储 X”战略的初步布局。此次并购所催生的新模式，其核心在于通过垂直整合创造独特客户价值，使公

司从产业链的中间环节，迈向能够定义产品标准、输出整体能力的关键主导者。借力此次产业并购，公司不仅扩充了存储器芯片领域的产品线、充实了相关技术储备，更进一步增强了自身在存储器芯片领域的全球战略布局。

（3）“存储+”战略

在“存储+”战略条线方面，公司自 2022 年起深化主业，同时向 MCU 及模拟芯片等领域延伸。截止 2026 年 6 月 30 日，公司已成功量产基于 M0+和 M4 内核的五大产品系列、超三百款 MCU 产品，累计出货量突破 30 亿颗，成功进入小米、美的、云鲸等头部品牌供应链；模拟芯片方面，VCM Driver 产品与 EEPROM 深度协同，开环产品导入多家品牌手机客户，新一代整合型产品简化客户选型；分离式 OIS 产品实现国内领先的大批量交付；首款闭环驱动芯片适配折叠屏、潜望摄像头等高端场景；新一代 OIS 芯片亦实现送样交付，此外，公司还新增了光圈马达驱动（Iris Driver）等国产替代应用，提升了公司在摄像头模组领域的竞争优势和市场占有率。

（4）全球化布局

在全球化拓展条线方面，公司积极布局海外市场，2026 年上半年外销收入达 25.67 亿元，占比 64.84%。SHM 在韩国和日本设有工程中心，并在全球多地建立了销售办事处，为公司构建了完善的全球销售网络。后续双方在产品协同、客户协同、销售渠道协同等方面将积极推进合作，促进公司深化全球化布局。

（5）公司发展阶段及市场环境的影响

近三年，受益于半导体去库周期结束、行业景气度回升、AI 算力需求爆发式增长以及公司“存储+”及“存储 X”战略的持续推进，公司营业收入保持快速增长。但受行业周期波动、研发投入加大、人力成本上升及存货减值等因素影响，利润端呈现出一定的阶段性波动。近三年主要财务指标如下表所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	2,319,754,086.04	1,803,569,661.85	1,127,050,035.41

营业收入同比增减 (%)	28.62	60.03	21.87
归属于上市公司股东的净利润	207,520,637.42	292,416,562.47	-48,274,289.54
归属于上市公司股东的净利润同比增减 (%)	-29.03	705.74	-158.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,143,267.54	269,267,908.74	-64,883,079.71
经营活动产生的现金流量净额	82,271,347.22	106,557,499.73	21,830,842.80
加权平均净资产收益率 (%)	8.97	14.06	-2.47
基本每股收益 (元/股)	1.40	1.98	-0.46
研发投入合计	297,285,079.91	241,967,234.34	191,293,296.98
研发投入占营业收入比例 (%)	12.82	13.42	16.97

2026 年上半年，在全球人工智能算力建设加速推进、存储芯片行业供给格局结构性优化的双重驱动下，公司经营业绩显著增长。报告期内公司实现营业收入 39.59 亿元，同比增长 336.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.27 亿元，同比增长约 1929.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8.25 亿元，同比增长约 2994.08%。营业收入、归母净利润及扣非净利润均创下历史同期新高。

报告期内业绩大幅增长主要受益于以下因素：第一，全球 AI 算力建设推动存储芯片行业供需格局优化，通用存储芯片产品价格维持上涨态势，存储业务实现量价同步改善；第二，公司持续落实“存储+”发展战略，MCU、Driver 等模拟新产品逐步渗透工业控制、AIoT 领域并实现规模出货，相关产品市场占有率稳步提升；第三，公司于 2025 年 11 月通过现金收购方式控制珠海诺亚长天存储技术有限公司 51% 股权，将其全资子公司 SHM 纳入上市公司合并范围，贡献了较为显著的营收与利润增量。

2、经营类指标分析

（1）经营波动原因分析及改善措施

回顾近三年经营情况，公司营业收入从 2023 年的 11.27 亿元增长至 2025 年的 23.20 亿元，三年复合增长率达 35.87%，呈现出强劲的增长态势。但利润端表现存在阶段性波动：2023 年受半导体行业下行周期去库存影响，公司归母净利润为-0.48 亿元；2024 年行业回暖，归母净利润回升至 2.92 亿元；2025 年虽营业收入持续增长，但归母净利润同比下降 29.03%至 2.08 亿元。

2025 年净利润下降的主要原因包括：一是受行业上下游价格变动节奏差异及产品结构变化影响，产品价格承压，毛利率同比下降 5.19 个百分点至 28.37%；二是公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 22.86%至 2.97 亿元，管理费用同比增长 51.51%，销售费用同比增长 49.02%，期间费用合计增加 1.28 亿元；三是公司面对新兴市场供需走势采取较为积极的备货策略，部分较长库龄存货计提减值损失对净利润产生一定侵蚀。

针对上述波动，公司已采取并持续深化以下改善措施：一是持续推进工艺迭代与产品升级，新一代 SONOS 平台 40E 系列产品及 ETOX 平台 4Xnm 制程产品已量产出货，有效巩固成本与性能优势；二是优化产品结构，大容量 256Mbit 至 1Gbit NOR Flash 产品成功导入 PC、服务器等领域大客户，高端工业、白电、通讯、汽车市场拓展稳步推进；三是构建全流程成本管控体系，升级供应链保障体系，提升精细化管理水平；四是强化外延并购效能，实现产品线互补与协同效应，促进 2D NAND 业务成为新的利润增长点。

2026 年上半年，上述改善措施的效果已充分显现。受益于存储芯片行业景气上行与公司战略布局的协同发力，公司毛利率显著修复，规模效应持续释放，扣非前后净利率均实现提升，业绩弹性得以体现。

（2）未来发展目标

公司制定了未来发展目标，并将每年进行动态调整：

存储业务方面：持续挖掘 SONOS 工艺平台在低功耗、高可靠性方面的潜力，提升产品竞争力，拓宽新型可穿戴、物联网等智能领域应用，同时做好下一代 SONOS 工艺技术储备；实现基于 ETOX 浮栅技术的 NOR Flash 的大容量产品量产完备化，覆盖通讯、工业控制、AI 边缘计算等市场；优化车规产品开发与验证体系，推动车载存储产品规模化应用，实现汽车业务收入占比翻倍增长。

“存储 X”业务方面：依托对诺亚长天的收购整合与技术协同，将 2D NAND Flash 打造为第三增长极，与 NOR Flash、EEPROM 形成完整覆盖，完成利基非易失性存储战略布局。依托 SHM 在全球多地建立的销售网络和客户资源，加速海外业务拓展，进一步扩大海外市场份额。

“存储+”业务方面：深入发挥嵌入式存储基因优势，打造差异化的高集成度产品；不断丰富 MCU 产品矩阵，覆盖从低成本应用到高性能、低功耗及功能安全需求的多元化市场；在模拟领域，确保系列音圈马达驱动产品通过头部摄像头模组厂及终端客户的严格认证，实现向主流手机及摄像头模组厂商的稳定批量供货；规划其他新品类模拟芯片的研发，与存储器和 MCU 产品形成系统级方案，提升单机价值量。

（3）资本工具运用的可行性

公司高度重视资本运作对产业发展的赋能作用，积极研究运用并购重组、再融资等资本市场工具，加速发展新质生产力、优化资产负债结构、提升资金使用效率。

并购重组方面：2025 年 11 月，公司通过现金收购方式控制珠海诺亚长天存储技术有限公司 51% 股权，将其全资子公司 SHM 纳入合并报表范围。SHM 为 2024 年全球第四大 SLC NAND 厂商，拥有成熟的固件算法开发能力和覆盖全球的销售网络。在 MLC NAND 市场中，随着 2025 年三星宣布退出 MLC NAND 的生产，SHM 的产能水平位于全球前列。此次并购不仅实现了业务边界的拓展与优势互补，更使公司完成了从单一芯片供应商向一体化存储解决方案提供商的转型。2025 年 12 月，公司进一步推出发行股份、可转换公司债券及支付现金购买诺亚长天剩余 49% 股权并募集配套资金的方案，交易对价 2.47 亿元。该方案已于 2026 年 4 月经

公司股东会审议通过，2026年5月获上交所受理，目前正在审核过程中。本次交易完成后，诺亚长天将成为公司全资子公司，SHM将成为公司全资孙公司，有利于公司进一步整合存储产业资源、强化核心竞争力。

再融资方面：公司本次重大资产重组同步募集配套资金不超过7,700万元，用于支付现金对价、中介费用及偿还诺亚长天并购贷款，有助于优化资产负债结构、降低财务成本。公司将根据业务发展需要和资本市场情况，合理运用各类融资工具，支持主业发展。

二、公司治理

公司持续完善治理结构，保障投资者知情权与参与权。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，规范召开董事会及股东会，确保决策程序合法合规。公司积极发挥独立董事和专门委员会的作用，独立董事全程参与董事会各项议题审议，重点对利益冲突相关事项开展监督，在重大投资、利润分配、关联交易等重大事项审议过程中，保障独立董事充分获取信息、独立行使审议权利，持续维护中小股东合法权益。

1、持续提升公司治理水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司围绕新《公司法》实施带来的治理规则变化，持续紧密跟踪《上市公司章程指引》等配套规范性文件制定与更新情况。报告期内，公司结合新规要求统筹推进内部制度修订工作，完成相关内部管理制度调整更新并发布实施，保障公司治理与制度建设持续符合最新法律法规与监管要求。公司持续优化内部运营流程，引入飞书办公系统实现数字化升级，全面提升公司整体工作效率与精细化管理水平。合同管理实现信息化系统全流程管控，项目管理进一步明确各阶段岗位职责与工作标

准，强化项目进度、质量与成本的全流程监控。同时，公司已开启 AI 本地化部署，探索深化日常工作流程与 AI 的高效协同，提高工作效率，完善工作输出。

公司持续强化内部监督与风险管理，完善内部控制体系，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整，为企业稳健运营与高质量发展筑牢了坚实的制度与安全屏障。

2、强化两会一层运作

公司持续健全董事会和股东会运作机制，严格执行议事规则与决策程序，确保两会一层的规范运作和科学决策。报告期内，公司董事会、股东会及各专委会、独立董事专门会运作规范、议事程序合规，公司全体董事及高级管理人员履职尽责，有效保障了公司治理的稳健运行。

3、关键少数培训与监管动态学习

公司高度重视“关键少数”的合规意识与履职能力建设。持续强化董事、高级管理人员法治思维、合规履职及风险防控能力，面向董事、高级管理人员常态化开展监管规则、合规风控专题学习培训，持续强化履职责任与风险意识，压实治理主体责任，筑牢公司规范运作根基。

公司持续关注资本市场最新监管规则与发展趋势，建立健全监管信息传递机制，及时将相关信息传达至董事会及管理层，确保公司经营管理与监管政策保持高度一致，积极配合资本市场监管机制。公司董事及高级管理人员对新《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》等重要法规进行了系统学习，切实将合规要求融入日常经营决策。

三、信息披露

1、规范法定信息披露

公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及相关监管规则，规范开展定期报告与临时公告的编制与披露工作，确保披露内容的真实、

准确、完整、及时，切实保障投资者的知情权。公司致力于构建多层次、全方位的信息披露体系，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司通过上海证券交易所网站和法定信息披露媒体，及时披露定期报告、临时公告及各类重大事项。

公司严格规范官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布机制，建立严格的内容审核与把关流程，确保自愿性披露内容的真实、准确、完整，谨防主动或被动卷入热点概念炒作。

公司建立了信息披露失职行为内部追责机制，严格落实《信息披露制度》相关责任追究要求，对信息披露过程中出现的相关行为进行内部溯源和责任追究，并针对性落实整改优化举措，持续夯实信息披露管理基础、提升信息披露质量。报告期内，公司未发生重大信息披露违规事项。

2、提升信息披露质效

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。在规范法定信息披露的同时，公司通过官网投资者关系专栏、微信公众号等渠道，以图文、视频等多元化形式向投资者展示公司经营情况和发展动态，提升信息透明度。公司主动召开业绩说明会，通过视频直播形式面向公众投资者解读业绩，设置互动问答环节，及时回应投资者关切。

公司持续完善内部管理机制和报告编制流程，提升报告的真实性和可读性，向投资者及社会公众完整呈现公司的责任实践与发展进程。

四、投资者回报

公司始终将股东回报作为重要工作方向，通过现金分红与股份回购相结合的方式，切实维护投资者利益。上市以来，公司已累计实施现金分红 1.23 亿元，并完成一期股份回购（累计回购 27.92 万股，回购金额约 3,509 万元）。2026 年 7 月，公司启动第二期股份回购，拟回购金额 3,000 万元至 5,000 万元，充分体现了管理

层对公司长期投资价值的认可和对投资者利益的维护。随着 2026 年业绩的持续增长，公司将在保障战略投入的前提下，将持续优化分红政策，提升股东回报水平。

1、回报类指标及股东回报

公司高度重视股东回报，将现金分红比例和股份回购作为回报类核心指标。2026 年上半年，公司实施完成 2025 年度利润分配方案，现金分红总额为 1,776.59 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 8.56%。分红比例较低的主要原因在于：公司所处半导体行业技术迭代较快，研发投入需求较高，且当前正处于“存储+”战略深化和 2D NAND 业务整合的关键阶段，公司需要将更多资金用于产品研发、产能布局和人才引进，以持续提升核心竞争力和中长期发展能力。公司已依法履行分红决策程序，并通过网络投票保障中小股东参与决策。

展望未来，随着公司盈利能力的显著提升，公司将结合业务发展现状、资本开支周期及净资产收益率等经营指标，动态优化分红政策，逐步提升现金分红比例，切实增强投资者获得感。

2、现金分红相关的资本配置安排

公司在制定分红政策时，充分考虑所处发展阶段、资本开支周期及 ROE 等经营指标的匹配性。当前，公司正处于由单一存储芯片供应商向平台型芯片企业转型的关键期，资本开支主要用于工艺迭代、产品升级、车规级芯片研发及并购整合等方面。2025 年公司加权平均净资产收益率为 8.97%，2026 年上半年已达 28.73%，盈利能力持续改善。

在各类股东回报工具的优先级与考量方面，公司遵循以下原则：第一，坚持常态化现金分红，保障股东持续稳定的现金回报；第二，适时实施股份回购，在股价出现非理性下跌时维护公司价值及股东权益；第三，统筹平衡分红、降杠杆、回购与投资并购之间的关系，在保障日常经营和战略投入的前提下，合理分配资本。董事会在进行资本配置决策时，将综合考虑公司盈利水平、现金流状况、债务结构、行业周期及战略规划等因素，确保资本配置方案既满足当期股东回报需求，又不损害公司中长期发展能力。

上市以来，公司已实施两期股份回购。第一期回购于 2022 年 8 月至 2023 年 8 月实施，累计回购股份 27.92 万股，回购均价 125.71 元/股，用于员工持股及股权激励计划。2026 年 7 月，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司控股股东、实际控制人、董事长王楠先生提议实施第二期股份回购，拟以自有资金 3,000 万元至 5,000 万元通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 909.88 元/股，用于维护公司价值及股东权益。截至本公告日，该回购方案已获董事会审议通过并进入实施阶段。

3、投资者交流机制

公司持续完善投资者交流机制，致力于提升公告可读性与投资者获得感。未来一段时间内，公司将重点推进以下工作：

（1）丰富业绩说明会形式：在定期报告发布后，通过图文演示、在线互动等形式召开业绩说明会，降低中小投资者与管理层交流的门槛；设置互动问答环节，及时、坦诚回应投资者关切。

（2）提升信息披露可读性：优化定期报告和临时公告的表述方式，增加图表化、可视化内容，使复杂的技术和财务信息更加直观易懂。

（3）拓展多元化沟通渠道：通过官网投资者关系专栏、邮箱、专线电话和上证 e 互动平台等渠道，与投资者保持密切沟通；积极接待机构和个人投资者调研，举办面向个人投资者的开放日活动，增进中小股东对公司业务逻辑和战略方向的理解。

（4）强化投资者反馈机制：建立投资者意见征询和反馈机制，将投资者关注的问题和意见建议及时传达至管理层，为持续优化投资者关系管理工作提供参考。

五、社会责任

公司积极履行社会责任，将 ESG 理念融入企业发展战略和日常经营。在环境保护方面，公司作为 Fabless 芯片设计企业，通过优化产品设计、推广低功耗工艺、

推动绿色供应链建设等方式，降低产品全生命周期的环境影响。在员工发展方面，公司建立了系统化的培训制度，设计多元化的培训课程以支持员工学习与成长，涵盖新员工入职培训、专业能力培训、管理层研修等类别；公司同时推行常态化股权激励计划，与常规薪酬福利共同构建完整的薪酬激励体系，充分调动员工积极性。在供应链责任方面，公司建立了良好的内部控制环境和业务连续性计划，确保供应链稳定安全。

六、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-60791797

邮箱：ir@puyasemi.com

公司网址：www.puyasemi.com

微信公众号：普冉股份



普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年8月19日